



kingston.com/epop

ePoP

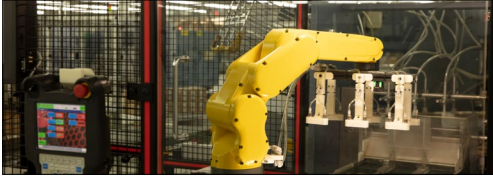
可穿戴裝置的內嵌層疊式封裝記憶體

Kingston 的 ePoP 採用高度整合的 JEDEC 標準元件，將內嵌多媒體卡 (eMMC) 儲存裝置與低功耗雙倍資料速率 (LPDDR) DRAM 結合於層疊式封裝 (PoP) 解決方案中。ePoP 可直接安裝於相容的系統單晶片 (SoC) 上方，不僅能節省印刷電路板 (PCB) 空間，亦可確保系統達到最佳效能，因此成為如可穿戴裝置等空間受限應用的理想選擇。

主要優點

- 藉由直接安裝在主機 SoC 頂端，ePoP 為小型尺寸應用 (例如可穿戴裝置) 提供了理想的解決方案。
- 低功耗 DRAM 和最佳化的儲存裝置韌體可降低功耗，同時提供電池供電的可穿戴裝置應用所需的高性能。
- 簡化系統設計，加快上市時間，並且縮短鑑定週期。
- 提供多種韌體態度，提供最適合您的應用程式在性能、功率和使用壽命方面的需要。

市場區隔



物聯網 (IoT)



可穿戴裝置



擴增實境 (AR) / 虛擬實境 (VR) 裝置

EPoP 產品型號及規格

LPDDR4x based ePoP

產品型號	儲存容量		說明		包裝	FBGA	作業溫度
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
64EP16-M4MTB9W	64	16	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.6	144	-25°C ~ +85°C
64EP32-M4NTB9W	64	32	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.65	144	-25°C ~ +85°C

LPDDR5x based ePoP

產品型號	儲存容量		說明		包裝	FBGA	作業溫度
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
64EP16-M5ATB9W	64	16	5.1	LPDDR5x	8x9.5x0.58	201	-25°C ~ +85°C
64EP32-M5BTB9G	64	32	5.1	LPDDR5x	8x9.5x0.65	201	-25°C ~ +85°C
64EP32-M5BTB9M	64	32	5.1	LPDDR5x	8x9.5x0.7	201	-25°C ~ +85°C